

上海硅产业集团股份有限公司 2023年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	319,030.13	360,036.10	-11.39
营业利润	17,867.77	41,830.26	-57.29
利润总额	17,765.21	40,327.24	-55.95
归属于母公司所有者的净利润	18,654.28	32,503.17	-42.61
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-16,290.45	11,524.88	-241.35
基本每股收益（元）	0.068	0.121	-43.80
加权平均净资产收益率	1.27	2.29	减少 1.02 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	2,907,024.75	2,546,260.64	14.17
归属于母公司的所有者权益	1,511,434.05	1,429,099.67	5.76
股本	274,717.72	273,165.87	0.57
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	5.52	5.30	4.15

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.编制合并报表的公司应当以合并报表数据填制；上年同期财务数据经过重述的，

应同时披露重述后的相关数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况说明

2023 年全球经济增速延续 2022 年的放缓趋势，且地缘政治紧张局势加剧带来新的挑战。受此大环境的影响，半导体行业仍处于周期性调整阶段，全球晶圆出货量明显下降。据 SEMI 统计，受终端市场持续疲软、半导体产业高库存和宏观经济状况影响，2023 年全球半导体硅片出货量相比 2022 年下降 14.3%。公司报告期的营业总收入受整体经济环境和半导体行业市场影响，较上年同期下降 11.39%。

报告期内公司多个扩产项目，包括集成电路用 300mm 高端硅片扩产项目、300mm 高端硅基材料研发中试项目和 200mm 半导体特色硅片扩产项目均有序推进，其中集成电路用 300mm 高端硅片扩产项目到 2023 年底已释放 15 万片/月的新产能，合计产能达到 45 万片/月。扩产项目在实施过程中会产生一定前期费用同时增加较大的固定成本，对公司报告期内的经营指标产生较大影响。

报告期内公司财务状况稳定，总资产、归属于母公司的所有者权益、归属于母公司所有者的每股净资产均有所增加。

（二）主要数据及指标增减变动幅度达 30% 以上的主要原因说明

公司报告期内的营业利润较上年同期下降 57.29%，利润总额较上年同期下降 55.95%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降 42.61%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 241.35%，基本每股收益较上年同期下降 43.80%，主要是由于公司受整体经济环境和半导体行业市场影响导致收入下降，同时扩产项目实施导致固定成本增加所致。

三、风险提示

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司 2023 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2023 年年度报告披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2024年2月24日